

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第3区分

【発行日】平成21年7月23日(2009.7.23)

【公開番号】特開2008-42512(P2008-42512A)

【公開日】平成20年2月21日(2008.2.21)

【年通号数】公開・登録公報2008-007

【出願番号】特願2006-214054(P2006-214054)

【国際特許分類】

H 03 H 9/02 (2006.01)

【F I】

H 03 H 9/02 A

【手続補正書】

【提出日】平成21年6月10日(2009.6.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

金属製リッド部材およびガラス製ベース部材を具備するパッケージにおいて、前記ベース部材は、所定部位を透明処理した硬質ガラス材のガラス基板に、ガラス対金属封着により、封着金属材のリードを貫通植設すると共に封着金属材のフレームを基板周辺部分に設け、前記ガラス製ベース部材のフレームに前記金属製リッド部材を金属融解または接合材により接合封止したことを特徴とする電子部品用パッケージ。

【請求項2】

前記ガラス基板は所定部位にプラスト、エッティング、または軟化ガラス状態でのプレスにより成形した窪みを設け、前記ガラス基板に植設したリードはパッケージ内面側で電子部品と接続したことを特徴とする請求項1に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項3】

前記所定部位は光の透過波長を抑制するコーティングを設けたことを特徴とする請求項2に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項4】

前記ガラス基板、フレームおよびリードのいずれかの表面に電極パッドまたは電気配線用パターンニングを設けたことを特徴とする請求項1に記載の電子部品用パッケージ。

【請求項5】

前記パターンニングがめっき処理、または、ろう材もしくははんだ材の塗布処理であることを特徴とする請求項4に記載の電子部品用パッケージ。